

令和8年度

京都実装技術研究会 第3回例会

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、本年度第3回例会を以下のとおり開催します。

◇ 開催日時 令和8年10月14日(水) 13:30 ~ 16:00

◇ 開催方式 会場/Web参加 併用(講師は会場でのご講演です)

会場所在地: 京都府産業支援センター 5階 研修室

(京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内)

◇ 内 容

講演① 「特注はんだコテ先の必要性と鉛フリーはんだ接合部のクラック率について」

講 師 ANDO実装研究所 所長 当田 貞行 氏

電子部品の開発段階・量産段階でこれまで携わってきた品質管理手法や信頼性評価試験の例について以前の例会で紹介を行った。今回、その講演で判明した特注のはんだこて先がほとんど採用されていないことについて改めて解説を行うほか、要望のあったヒートサイクルによる鉛フリーはんだ接合部のクラック率に焦点をあてより具体的に紹介を行う。

講演② 「基板へのはんだ付け作業、こて先の選定と使用例」

講 師 太洋電機産業株式会社 東京営業所 所長 片岡 栄一郎 氏

近年の熱対策多層基板は、部品の温度上昇を抑える構造上、はんだ付けに必要な熱が奪われやすく、はんだ付け性が著しく低下している。本来はリフロー炉やフロー槽(噴流槽)で実装すべき基板であっても、設計上の制約等により、はんだ付けロボットや「はんだこて」による手作業による実装を行わざるを得ないケースがある。今回、熱対策多層基板によるはんだこて作業において問題になりやすい事例と対策を、こて先形状と当て方にフォーカスし、熱容量に応じたこて先形状の選定基準といった基礎から、熟練者の経験に頼らない具体的改善アプローチまでを解説する。

※例会後は懇親会も開催します(会費は研究会より補助)

◇ 定 員 会場: 40名 WEB: 40名

◇ 参 加 費 会員: 無料 非会員: 10,000円/社

(研究会入会希望の方は事務局までお問合せください。年会費20,000円/社)

◇ 申込締切 令和8年10月9日(金)(懇親会は10月7日(水)締切)

◇ 申込方法 当センターホームページからお申込みいただけます。
(<https://www.kptc.jp/kenkyukai/261014jisso/>)

※E-mail 又は FAX でもお申込みいただけます

◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係

(京都実装技術研究会事務局) jisso@kptc.jp / TEL 075-315-8634

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係 宛て
(jisso@kptc.jp 又は FAX 075-315-9497)

令和8年度 京都実装技術研究会 第3回例会申込書

会社名				
所在地				
連絡担当者	所属・役職			
	氏名			
	E-mail			
	電話番号			
	参加方法	☐ 会場 ☐ Web ☐ 連絡のみ担当（本人は不参加）		
	懇親会	☐ 参加 ☐ 不参加		
上記以外の参加者	所属・役職	氏名	E-mail ※個別連絡も希望する場合は記入	懇親会
				☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 参加 ☐ 不参加
				☐ 参加 ☐ 不参加
質問事項 (任意記入)	講師の方や例会参加者への質問を募集します。普段気になっているけれど、聞く機会がないことなど、自由にご記入ください。意見交換トピックとして紹介させていただきます。			

※申込締切：令和8年10月9日(金)まで

懇親会へのご参加を希望される場合は10月7日(水)までにお申込みください。

（期限後にご連絡いただいた場合は、会場手配の都合上、参加をお断りする場合があります。）

※申込書にご記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用します。